

苏州电器科学研究院股份有限公司
关于拟向北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划
（非公开定向债务融资）的公告

公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月3日第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》。公司本次发行债权融资计划尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将本次拟发行债权融资计划的具体方案和相关事宜说明如下：

一、发行北京金融资产交易所债权融资计划的具体方案

为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构，降低财务费用，公司拟通过申请发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”）的方式筹集资金，拟发行金额为人民币1.5亿元，具体方案如下：

1、注册额度

本次发行债权融资计划的规模不超过1.5亿元。

2、发行期限

本次发行债权融资计划的期限不超过3年。

3、发行利率

公司本次申请发行的债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

4、募集资金用途

用于偿还、置换有息负债，补充营运资金等符合监管机构要求的相关用途。

5、发行时间

根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内一次性/分期、择机发行。

6、发行方式

采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在备案有效期限及注册额度内，根据自身资金需求状况及相关规定择机一次性/分期发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。

7、发行对象

北京金融资产交易所认定的合格投资者。

8、主承销商

招商银行股份有限公司。

二、本次发行北京金融资产交易所债权融资计划的授权事项

为保证公司债权融资计划（非公开定向债务融资）顺利发行，提请股东大会授权董事会全权处理本次发行债权融资计划（非公开定向债务融资）的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次申请债权融资计划（非公开定向债务融资）发行申报事宜。

3、代表公司进行所有与本次债权融资计划（非公开定向债务融资）发行相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划（非公开定向债务融资）有关的合同、协议和相关的法律文件。

4、及时履行信息披露义务。

5、办理与本次发行债权融资计划（非公开定向债务融资）有关的其他事项。

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：本次拟发行债权融资计划的方案合理，切实可行，有利于拓宽公司融资渠道，有利于优化负债结构，提高资金利用效率，有利于公司保持长期、持续、健康的发展，符合公司发展需要。本次拟发行债权融资计划的方案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

基于上述情况，我们同意公司按照拟发行债权融资计划方案的内容推进相关工作；同意将上述拟发行债权融资计划的相关议案提交公司股东大会审议。

四、审批程序

本次发行事项经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需获得北京金融资产交易所的备案。

以上事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准方可实施。

五、备查文件

1、《苏州电器科学研究院股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》

2、《苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会

二〇二一年三月四日